

# 组合式连接器 (SIM卡8销用, microSD™卡)

SCHG系列



支持SIM卡8销的双层结构。



## 特长

- 可以允许SIM卡(8销)和microSD™卡2种卡分别插入的双层(2槽口)结构。

## 用途

- 手机, 各种便携式信息终端, 笔记本电脑

## 主要规格

项目		规格	
构造	适用媒体	SIM卡8销	
		microSD™	
	贴装方式	表面贴装型	
	贴装状态	标准贴装	
媒体排出方式		手插拨式/双响键式	
性能	使用温度范围		-25°C to +70°C
	耐高压		500V AC 1minute
	绝缘电阻(初期)		1,000MΩ min.
	接触电阻(初期)	连接接点	100mΩ max.
		感知开关	500mΩ max.
插拔回数		5,000cycles (SIM卡8销) / 10,000cycles (microSD™卡)	

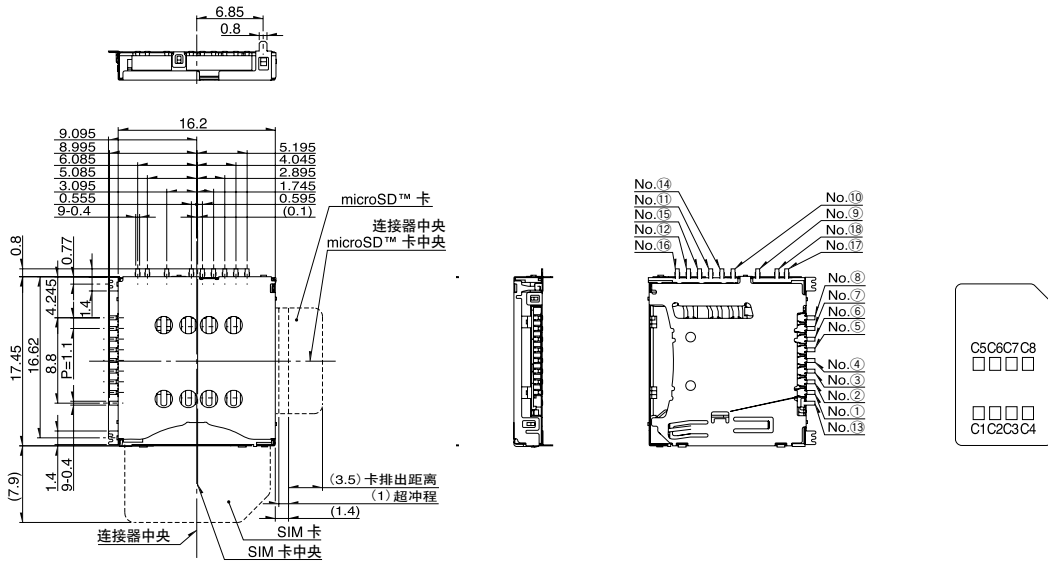
## 产品一览

媒体排出方式	贴装状态	基准距 (mm)	包装状态	产品编号
双响键式	标准贴装	0	贴纸	SCHG1B0100

外形图

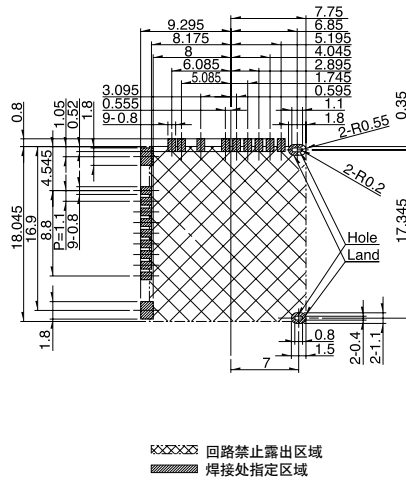
Unit:mm

形状



PIN ASSIGNMENTS					
CONNECTOR TERMINAL No.	PIN No.	PIN LAYOUT	CONNECTOR TERMINAL No.	PIN No.	PIN LAYOUT
No.1	microSD No.1	DAT 2	No.9	SIM No.C1	VCC
No.2	microSD No.2	CD/DAT3	No.10	SIM No.C2	RST
No.3	microSD No.3	CMD	No.11	SIM No.C3	CLK
No.4	microSD No.4	VDD	No.12	SIM No.C4	RESERVED
No.5	microSD No.5	CLK	No.13	SIM No.C5	GND
No.6	microSD No.6	VSS	No.14	SIM No.C6	VPP
No.7	microSD No.7	DAT0	No.15	SIM No.C7	I/O
No.8	microSD No.8	DAT1	No.16	SIM No.C8	RESERVED

印刷电路板安装孔尺寸图 (从贴装面看)



SD内存卡用

microSD™卡用

SIM卡8销用

W-SIM用

Memory Stick™用

Memory Stick™用

组合式

Compact Flash™用

CardBus卡用

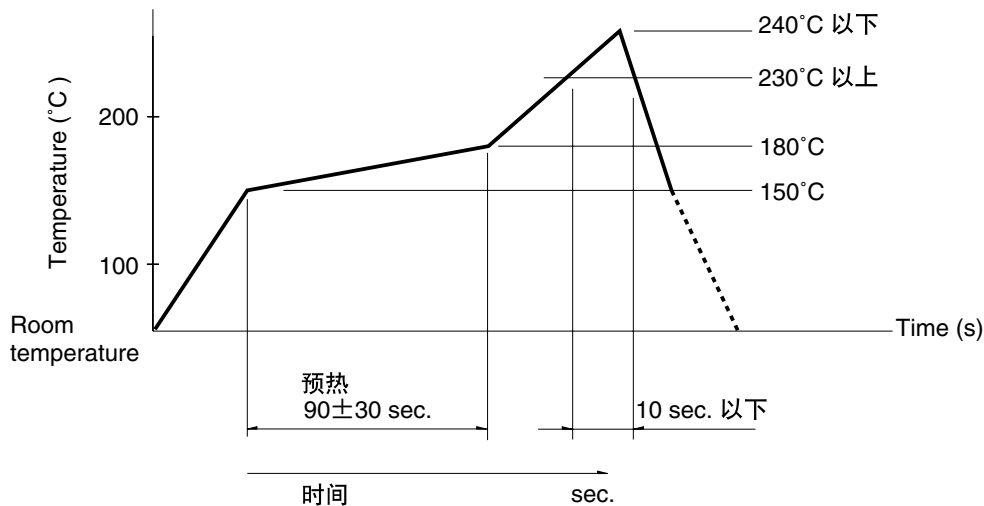
Express Card™用

CMOS摄影模块用

## 焊锡条件

回流方式的参考举例

1. 加热方式 为由热风循环的上下加热方式。
2. 温度测量方式 使用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的CAK或CCT测量。固定方式采用耐热胶带。



## 使用本产品时的注意事项

1. 在对端子进行焊接时，请注意，如果给端子施加负荷，根据条件不同有造成松动，变形及电特性降低的可能。
2. 焊接时，水溶性助焊剂有使开关腐蚀的可能，请避免使用。
3. 关于回流条件的设定，请根据实际的批量生产条件进行确认。
4. 由于电路板的弯曲可能引起特性的变化，请充分考虑模式设计及布局设计。
5. 产品对应符合SD Association (SDA) 规格，MultiMediaCard (MMCA) 规格，CompactFlash Association (CFA) 规格，Memory Stick™ 规格书的卡。使用不符合上述规格的卡时，可能不正常动作。

SD内存卡用

microSD™卡用

SIM卡8销用

W-SIM用

Memory Stick Micro™用

Memory Stick™用

组合式

Compact Flash™用

CardBus卡用

Express Card™用

CMOS摄影模块用